			may aby constant b.	
	SN	MT Traveler 表面	贴簑流程卡	公司图标
a and a state to the		. Not., but	and the state of t	
Lot Number 内部批号	Start Quantity 开始	数重	Product Name 产品名称	
	被动元器件数量:			
	片条数量:			
Customer Lot Number 客户批号		Lot Type 批次类型	Part Number 产品编码	
		Lot Type 批次央型	rait Number / 加州阿	

Substrate Baking 基板烘烤	Equip.ID 设备号码		Employee ID 员工工号	Good Qty 良品数量	Defects/Scraps 不良品数量	Wafer Qty 条数	Date 日期
		In 进料					
		Out 出料					
Mag. Out 结束料盒号码							
1) Step #1 Temp. (deg C) =	3) Program Name =						
2) Step #1 Time (min) =							

Solder Paste Printing 锡膏印刷	Equip.ID 设备号码		Employee ID 员工工号	Good Qty 良品数量	Defects/Scraps 不良品数量	Wafer Qty 条数	Date 日期
		In 进料					
		Out 出料					
Mag. Out 结束料盒号码							
1) Stencil =	3) Program Name =		Name =				
2) Squeegee =							

Component Mount 元件贴片	Equip.ID 设备号码		Employee ID 员工工号	Good Qty 良品数量	Defects/Scraps 不良品數量	Wafer Qty 条数	Date 日期
		In 进料					
		Out 出料					
Mag. Out 结束料盒号码							

Reflow 回流焊	Equip.ID 设备号码		Employee ID 员工工号	Good Qty 良品数量	Defects/Scraps 不良品数量	Wafer Qty 条数	Date 日期
		In 进料					
		Out 出料					
Mag. Out 结束料盒号码							

Water Cleaning 水洗	Equip.ID 设备号码		Employee ID 员工工号	Good Qty 良品数量	Defects/Scraps 不良品数量	Wafer Qty 条数	Date 日期
		In 进料					
		Out 出料					
Mag. Out 结束料盒号码							
				•	•	•	•

Visual Inspection 目检	Equip.ID 设备号码		Employee ID 员工工号	Good Qty 良品数量	Defects/Scraps 不良品数量	Wafer Qty 条数	Date 日期
		In 进料					
		Out 出料					
Mag. Out 结束料盒号码							

QA Inspection QA 检验	Equip.ID 设备号码		Employee ID 员工工号	Good Qty 良品数量	Defects/Scraps 不良品数量	Wafer Qty 条数	Date 日期
		In 进料					
		Out 出料					
Mag. Out 结束料盒号码							